

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

投资者关系活动记录表（2024年半年度业绩说明会）

编号：202405

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（投资者策略会）
参与单位名称及人员姓名	通过上证路演中心网络互动平台参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024年9月10日 14:00-15:00
地点	上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理马卓、独立董事洪芳、董事会秘书吴玉梅、财务总监刘望兰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要内容整理如下：</p> <p>问1：请问怎么看公司未来业绩增长点？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！一方面，随着募投项目投产，2024年公司在深圳工厂、信丰一厂基础上增加了信丰智能化工厂，公司样板+批量一站式服务能力得以大幅提升。伴随着产能逐步爬升，公司经营业绩边际将慢慢迎来改善。</p> <p>另一方面，随着产能释放，公司将会不断增加样板小批量、高多层及HDI等高附加值订单占比，以优化产品结构，提高产品附加值以提升盈利能力。感谢您的关注！</p> <p>问2：公司上半年营业收入同比增长5.01%，具体是哪些下游领域带动？下半年预计是否可持续？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！受益于消费电子市场弱复苏，公司智能安防、汽车电子、智能消费设备、计算机及服务器等</p>

领域订单稳步增长，助推公司 PCB 销量较去年同比增长了 18.24%，实现了产能稳步爬升。感谢您的关注，谢谢！

问 3：请问 2024 年半年度公司业绩下滑的主要原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！2024 年上半年经营情况主要受宏观经济等不确定因素持续影响，市场需求仍较为疲软，虽公司 PCB 销量较去年同比增长了 18.24%，但整体产能仍未充分利用，使得产品单位固定成本依然较高，边际效益未显现；叠加行业价格竞争激烈，价格仍未有明显改善，使得公司营业收入仅实现微幅增长，而公司利润承压明显。

而公司 2024 年半年度相较去年同期业绩下滑主要系财务费用中外币产生汇兑收益减少及利息支出增加，叠加研发费用有所增加导致期间费用增加所致。

未来，公司将持续加大市场开拓力度，加快产能爬坡，实现规模效应，努力降低不利因素对公司生产经营产生的影响。感谢您的关注！

问 4：请问公司目前整体订单情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前整体订单情况较为稳定，公司未来将持续聚焦汽车电子、新能源（光伏储能）、5G 通信、人工智能等市场，加大开发力度。感谢您的关注！

问 5：请问贵公司互联网+智慧型样板生产基地项目进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！为把握行业发展机遇，更好满足市场日益增长的研发创新活动对 PCB 样板的需求，继信丰智能化大批量工厂之后，公司稳步推进珠海迅捷兴互联网+智慧型样板生产基地项目实施。报告期，智慧型样板生产基地项目建筑工程已临近完工，公用配套设施（含环保设施、暖通、供配电、工程精装修等）项目正在施工中，部分定制化设备已完成合同签约。同时互联网接单平台、工程自动化项

目按计划推进，争取在智慧型样板生产基地项目投产前上线使用。

公司将继续稳步推进互联网+智慧型样板基地项目实施，谋求特色化发展，通过样板批量化生产新模式，有效提升公司 PCB 样板生产能力，并进一步提升公司在 PCB 样板市场的竞争地位。感谢您的关注！

问 6：根据 2024 年半年报显示，公司 2024 年 6 月末掌握的主要核心技术与 2023 年末相比无差异，公司 2024 年上半年的研发投入同比增长 18.78%，请问上半年公司在核心技术上主要取得了哪些重要进展？

答：尊敬的投资者，您好！上半年度，围绕新兴市场新产品、新技术需求，公司继续加大研发投入，稳步推进“应用于 5G 承载网的 100G 光模块产品开发”、“应用于 5G 通讯领域的 25Gbps 高速电路板开发”、“应用于大数据系统的 Whitely 高端服务器电路板开发”等 16 个在研项目实施。其中在新板材研究开发方面，公司对高频板材特性、对 M6、M7 等级的高速板材加工应用、对“高速板材+ FR4 的 PP 混压”的机理和使用方法进行了深入研究，为公司雷达天线产品、高速产品的顺利量产起到了有力支撑。另外，在制程能力提升方面，公司对线路精度，阻抗精度，对准度，图形位置精度，电镀深镀能力，外形尺寸精度等工艺能力进行了改进，为高精度高难度产品生产制造和开发提供了技术支撑。

同时，为加快业务开拓，技术中心与市场积极联动，紧紧围绕重点市场大客户需求，寻求重点产品技术能力突破。报告期，公司在应用于 5G 通信等交换机、路由器、服务器、100G 光模块产品方面，应用于 5G 通讯、数据中心，智能驾驶、毫米波雷达、人工智能 AI、天线/雷达等领域的 AAU、BBU 高频高速产品方面，应用于充电桩领域厚铜产品方面，应用于 5G 通信三阶 HDI 产品等方面不断取得技术突破，进一步提升了

	相关产品技术能力，为公司 5G/6G 通讯、数据中心、汽车电子、新能源等业务深度开拓，进一步提高目标市场订单份额提供了有力支持。感谢您的关注！
附件清单（如有）	